

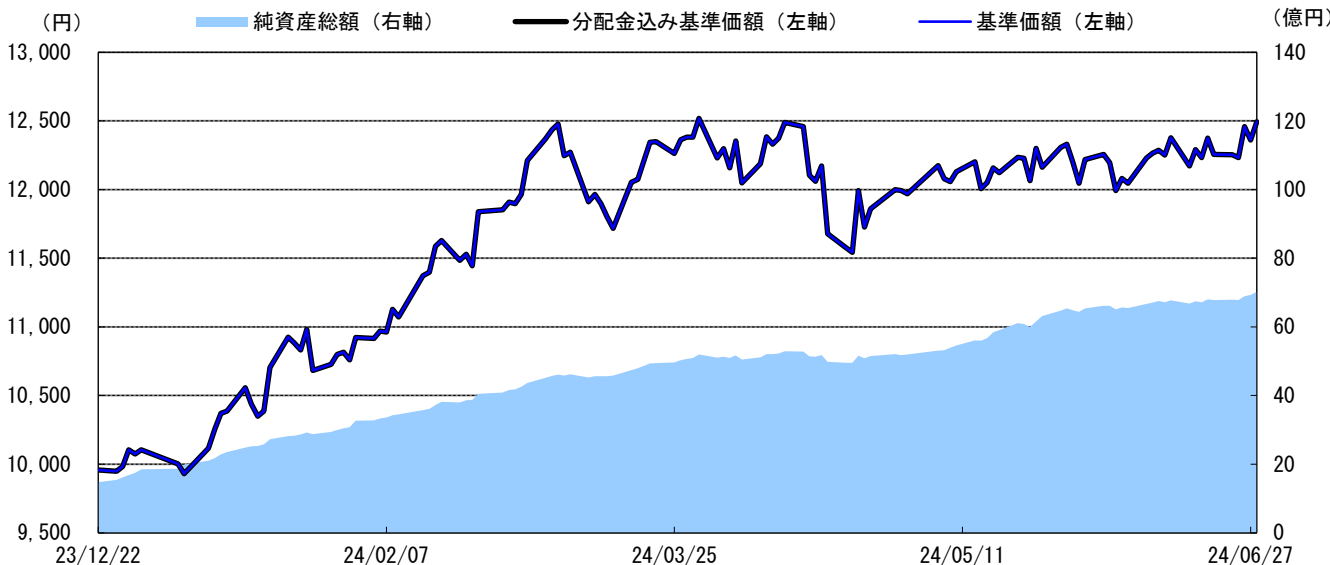
ジャパン半導体株式ファンド

設定日：2023年12月22日 償還日：無期限 決算日：原則、毎年12月20日
 収益分配：決算日毎 基準価額：12,495円 純資産総額：70.22億円

※このレポートでは基準価額および分配金を1万口当たりで表示しています。
 ※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。
 ※当レポートのグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

運用実績

<基準価額の推移>



※分配金込み基準価額の推移は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を再投資したものと計算した理論上のものである点にご留意ください。
 ※基準価額は、信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の値です。

<基準価額の騰落率>

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	設定来
2.26%	-0.19%	23.66%	-	-	24.95%

※基準価額の騰落率は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を再投資したものと計算した理論上のものである点にご留意ください。

<分配金実績（税引前）>

分配金合計					
0円					

※分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。

<資産構成比>

株式	97.2%
うち先物	0.0%
現金その他	2.8%

投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。

■当資料は、投資者の皆様にご理解を高めることを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

ポ ートフォリオ の 内容

※下記は、マザーファンドの状況です。

※「市場別構成比」「規模別構成比」「投資カテゴリー別構成比」は、組入銘柄の評価額の合計を100%として計算したものです。

※「業種別構成比上位」「組入上位10銘柄」は、純資産総額比です。

※「組入上位10銘柄の銘柄概要」は、後述をご参照ください。

<市場別構成比>

市場	比率
プライム	98.8%
スタンダード	1.2%
グロース	0.0%
その他	0.0%

<規模別構成比>

時価総額	比率
1兆円以上	44.0%
5,000億円以上1兆円未満	25.7%
2,000億円以上5,000億円未満	14.1%
2,000億円未満	16.2%

<業種別構成比上位>

業種	比率
1 電気機器	41.2%
2 機械	24.9%
3 化学	12.0%
4 卸売業	7.9%
5 建設業	6.5%
6 輸送用機器	2.6%
7 金属製品	2.2%
8 精密機器	0.7%
9 情報・通信業	0.3%
10 サービス業	0.3%

<投資カテゴリー別構成比>

投資カテゴリー	比率
半導体製造装置・半導体材料企業	76.2%
半導体の製造にかかわる企業	15.8%
恩恵を受ける周辺企業	7.9%

※投資カテゴリーは日興アセットマネジメントが考える分類です。

※当ファンドの投資カテゴリーは上記に限定されるものではなく、将来、変更となる可能性があります。

<組入上位10銘柄> (銘柄数 52銘柄)

	銘柄	業種	投資カテゴリー	比率
1	アドバンテスト	電気機器	半導体製造装置・半導体材料企業	5.40%
2	イビデン	電気機器	半導体製造装置・半導体材料企業	5.18%
3	荏原製作所	機械	半導体製造装置・半導体材料企業	5.00%
4	東京エレクトロン	電気機器	半導体製造装置・半導体材料企業	4.64%
5	ディスコ	機械	半導体製造装置・半導体材料企業	4.06%
6	オルガノ	機械	半導体製造装置・半導体材料企業	3.76%
7	芝浦メカトロニクス	電気機器	半導体製造装置・半導体材料企業	3.66%
8	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	半導体の製造にかかわる企業	3.33%
9	ローツェ	機械	半導体製造装置・半導体材料企業	2.98%
10	長瀬産業	卸売業	半導体製造装置・半導体材料企業	2.90%

※個別銘柄の取引を推奨するものでも、将来の組入れを保証するものでもありません。

投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。

■当資料は、投資者の皆様にご理解を高めいただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

運用コメント ※運用方針等は作成基準日現在のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。

◎市場環境

6月の国内株式市場は、東証株価指数（TOPIX）が前月末比プラス1.34%の上昇、日経平均株価が同プラス2.85%の上昇となりました。欧州政治の先行き不透明感や米国の経済指標が米国景気の軟化を示し投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどが株価の重しとなったものの、米国連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ観測の後退などから円安／アメリカドル高が進み、輸出企業の好調な業績が期待されたことや、米国の大手半導体企業の株価が上昇したのを背景に半導体関連の銘柄を中心にハイテク株が上昇したことなどが株価の支援材料となり、国内株式市場は上昇しました。

東証33業種分類では、保険業、倉庫・運輸関連業、サービス業などの14業種が上昇する一方で、ゴム製品、電気・ガス業、海運業などの19業種が下落しました。

◎運用概況

当ファンドは、拡大する半導体需要を支える日本の半導体関連産業を、①半導体の製造にかかわる企業、②半導体製造装置や半導体材料の供給を行なう企業、③国内半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺企業という3つの投資カテゴリーで捉え投資を行ないます。

当月の主な投資行動につきましては、引き続き半導体製造装置や半導体材料の供給を行なう企業（カテゴリー②）を中心に銘柄を選定し、今後成長が見込まれる後工程に強みを持つ半導体製造装置企業への投資も継続しました。個別銘柄では半導体ウエハの搬送装置を供給する銘柄を1銘柄、半導体製造装置に使われる部品を提供する銘柄を1銘柄、新規に組み入れました。一方で、株価上昇や他銘柄との相対感からS i Cに関連する銘柄を1銘柄売却しました。

このような運用の結果、当月末における当ファンドの基準価額は、12,495円となりました。

◎今後の見通し

国内株式市場は、ほぼ横ばいの推移となりました。セクター別では、保険、倉庫・運輸関連、サービス、情報・通信が上昇し、特徴としては中小型株が上昇しやすい相場となりました。そのような中で、半導体関連銘柄の株価もほぼ横ばいの推移となりました。個別銘柄では後工程関連が堅調な株価推移となり、I R D a yなどのイベントの開催も一部株価を押し上げる要因となりました。

半導体の需要面では引き続きスマートフォンやPC向けの回復感の弱さがみられています。しかしながら、今後スマートフォンやPCへのA I搭載に対する期待感の高まりから一部テクノロジー関連銘柄の上昇がみられました。データセンターへの投資需要は引き続き強く、6月27日（米国時間）に発表されたマイクロン・テクノロジーの決算においても、DRAMやNANDなどメモリーの回復感がより顕著に示されており、今後半導体需給の改善と半導体市場の更なる拡大が期待される内容でした。

短期的にはウクライナや中東情勢、米国や日本における金融政策の変更、米中関係の変化、中国経済の低迷などのリスクを株式市場が織り込んでいく可能性には留意が必要と考えています。しかしながら、半導体需要は、2024年以降のA I関連を中心とした成長への期待感を引き続き高く、中長期的にも自動車の自動運転・電動化、I o Tの拡大に伴う高い成長が見込まれます。また、今後成長が見込まれる高性能半導体分野では微細化だけでなくパッケージの高度化など後工程技術の進化による性能向上が求められています。日本には後工程に強みを持つ半導体関連企業も多く、後工程技術の進化に伴い高い成長が期待されます。加えて、日本では政府からの補助金の後押しもあり大規模な半導体工場の建設や、半導体工場建設に伴う周辺産業の活性化も見込まれています。

ポートフォリオの構築においては、この拡大する半導体需要を支える日本の半導体関連産業を、①半導体の製造にかかわる企業、②半導体製造装置や半導体材料の供給を行なう企業、③国内半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺企業という3つの投資カテゴリーで捉え投資を行なう方針です。

投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。

■当資料は、投資者の皆様にご理解を高めることを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

ご参考情報

※個別銘柄の取引を推奨するものでも、将来の組入れを保証するものでもありません。
 ※記載の見解等は、作成基準日現在のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。

<組入上位10銘柄の銘柄概要>

1 アドバンテスト
SoC(システム・オン・チップ)、メモリ向けのテストを軸に、システム・レベル・テストといった半導体のテスト・ソリューションを揃えている。ハイパフォーマンスコンピューティング向けの市場で、高い市場シェアを築いている。今後、2.5D、3Dパッケージが市場に浸透する中で、高い成長力を期待。
2 イビデン
半導体パッケージでグローバルトップレベルの技術を持つ。今後、AIなどが普及によりサーバー投資が活発化する中で、パッケージの更なる高性能化が求められ、多層化・大型化が進むことで高い成長が期待できる。
3 荏原製作所
ポンプや半導体製造装置など多岐にわたる産業機械を扱う企業。半導体製造装置ではCMP(Cheical Mechanical Polishing)で高いシェアを持つ。半導体の製造が複雑化する中、CMP装置の重要度が高まっている。今後は、同装置の活躍の場が更に拡大するとみられる。
4 東京エレクトロン
グローバルトップレベルの半導体製造装置メーカー。コーター・デベロッパー、エッチング、成膜など各前工程でシェアの高い製品を持つ。また、今後、後工程の技術進歩に伴い、プローバーやウエハボンダーなどの需要拡大にも期待ができる。
5 ディスコ
半導体後工程のダイシング(切る)、グライインディング(削る)、ポリッシング(磨く)の工程において高いシェアを持つことに加えて、消耗品の販売による比較的安定した収益源も持つ。今後は加工が難しいSiCなどのパワー半導体用途で需要拡大が期待される。
6 オルガノ
総合水処理エンジニアリング企業で高い水処理技術を持ち、半導体工場や原子力発電所向けに超純水を供給している。国内外の半導体工場向けに水処理装置の納入実績を持ち、今後日本国内において半導体工場が増設されることによる需要が期待できる。
7 芝浦メカトロニクス
半導体、フラットパネルディスプレイ、電子部品などの用途向けに製造装置を扱う。半導体向けでは前工程の洗浄やエッチング技術に強みを持ち、後工程向けにおいても今後拡大が見込まれる2.5Dパッケージ向けのボンディング装置に強みを持つ。
8 ルネサスエレクトロニクス
マイコンにおいてグローバルトップクラスのシェアを持ち、アナログ・パワー半導体も含む各種半導体を、自動車、産業、インフラ、IoT分野などに提供している。自動車の電動化や運転支援システムの普及により、自動車における半導体使用率が高まることが期待される。
9 ローツェ
半導体ウエハ搬送システムに強みを持つ企業。米国、中国、台湾などの半導体製造装置企業や半導体メーカー向けを中心に事業を展開している。今後中国の半導体国産化や装置国産化が進む中で事業拡大が期待できる。
10 長瀬産業
樹脂原料・添加剤から機能性ポリマー、プラスチック製品、電子材料、機能性食品素材、医薬原料・中間体まで、様々な商品を扱う化学商社。Rapidus社の材料輸送のとりまとめ業者の1社であることに加えて、子会社のナガセケムテックスで先端半導体向けの封止材料の製造も行っている。

投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。

■当資料は、投資者の皆様にご理解を高めることを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

ファンドの特色

**主として、わが国の金融商品取引所に上場されている半導体関連企業の株式に投資を行ないます。**

- 半導体関連企業には、半導体製造装置や半導体材料の供給を行なう企業、半導体の製造にかかわる企業のほか、半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺産業の企業などがあります。

**日本株式の調査・運用に精通した日興アセットマネジメントが運用を行ないます。**

- 高い専門性を有したアナリストおよびファンドマネージャーによる徹底したボトムアップ・リサーチなどに基づき、運用を行ないます。

**年1回、決算を行ないます。**

- 毎年12月20日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。

※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。

投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。

■当資料は、投資者の皆様にご理解を高めることを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

■お申込みメモ

商品分類	追加型投信／国内／株式
購入単位	販売会社が定める単位 ※販売会社の照会先にお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の基準価額
信託期間	無期限（2023年12月22日設定）
決算日	毎年12月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。 ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
換金価額	換金申込受付日の基準価額
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
課税関係	原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります。 ※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度（NISA）の適用対象です。 ※2024年1月1日以降、公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。上記は、2023年9月末現在のものです。税法が改正された場合などには、変更される場合があります。 ※配当控除の適用があります。 ※益金不算入制度は適用されません。

■手数料等の概要

投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。

<申込時、換金時にご負担いただく費用>

購入時手数料

購入時の基準価額に対し3.3%（税抜3%）以内

※購入時手数料は販売会社が定めます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。

換金手数料

ありません。

信託財産留保額

ありません。

<信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用>

運用管理費用

ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.584%（税抜1.44%）

（信託報酬）

その他の費用・手数料

目論見書などの作成・交付および計理等の業務に係る費用（業務委託する場合の委託費用を含みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。

組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。

※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。また、有価証券の貸付は現在行なっておりませんので、それに関連する報酬はかかりません。

※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■委託会社、その他関係法人

委託会社

日興アセットマネジメント株式会社

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

販売会社

販売会社については下記にお問い合わせください。

日興アセットマネジメント株式会社

〔ホームページ〕www.nikkoam.com/

〔コールセンター〕0120-25-1404（午前9時～午後5時。土、日、祝・休日は除く。）

■お申込みに際しての留意事項**○リスク情報**

- ・ 投資者の皆様は投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様には帰属します。なお、当ファンドは 預貯金とは異なります。
- ・ 当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

主なリスクは以下の通りです。

【価格変動リスク】

- ・ 株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
- ・ 中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。

【流動性リスク】

- ・ 市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
- ・ 一般に中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高いと考えられます。

【信用リスク】

- ・ 投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

【為替変動リスク】

- ・ 外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

○その他の留意事項

- ・ 当資料は、投資者の皆様へ「ジャパン半導体株式ファンド」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
- ・ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ・ 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- ・ 分配金は、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合があります。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- ・ 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様には帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

設定・運用は 日興アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは

金融商品取引業者等の名称	登録番号	加入協会				
		日本証券業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会	
あかつき証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第67号	○	○	○	
岩井コスモ証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長（金商）第15号	○	○	○	
株式会社千葉興業銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第40号	○			
東武証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第120号	○			
西尾信用金庫	登録金融機関	東海財務局長（登金）第58号	○			
丸八証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長（金商）第20号	○			
株式会社三菱UFJ銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第5号	○		○	○
明和証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第185号	○			
めぶき証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第1771号	○			

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。